

Analoge Schaltungsteile in einem 4-kbit-CMOS-RAM

Autor(en): **Feller, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **73 (1982)**

Heft 3

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-904927>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Analoge Schaltungsteile in einem 4-kbit-CMOS-RAM

E. Feller

621.3.049.774.2; 621.3.049.037.33;

Die hohe Speicherdichte in einem RAM erfordert eine analoge Schaltungstechnik für die Speicherzelle, Y-Selektion und den Leseverstärker. Diese Teile und ihre Arbeitsweise werden am Beispiel eines $1\text{ k} \times 4\text{-bit-RAM}$ vorgestellt. Ein Kriterium für die richtige Dimensionierung der Speicherzelle wird skizziert. Die Schaltung des sehr schnellen Leseverstärkers wird kurz besprochen.

La grande capacité d'une RAM nécessite une technique de couplage analogique pour ses cellules, la sélection Y et l'amplificateur de lecture. Ces parties et leur fonctionnement sont décrits en prenant comme exemple une RAM de $1\text{ k} \times 4\text{ bits}$. Un critère pour le dimensionnement correct des cellules est indiqué et le circuit de l'amplificateur de lecture très rapide brièvement traité.

1. Einleitung

Moderne Digitalrechner, Prozessrechner und Mikroprozessoren benötigen als Arbeitsspeicher schnelle, leistungsarme und platzsparende Halbleiterspeicher. Solche Speicher sind aus einer Vielzahl von integrierten Schaltungen zusammengesetzt. Sie enthalten als wichtigste Bauteile sog. Random Access Memories (RAM), das sind Lese/Schreib-Speicher mit direktem Zugriff zu allen Speicherplätzen. Je nach Speicherorganisation bestehen die Speicherplätze aus einzelnen Bit, Byte oder aus längeren Binärworten.

Es existieren viele verschiedene Arten von RAM. Sie unterscheiden sich in der verwendeten Technologie, der internen Schaltungstechnik, welche eng mit der Technologie verknüpft ist, und den äusseren Eigenschaften ganz beträchtlich. Eine Darstellung dieser Vielfalt würde den Rahmen des Themas wohl sprengen. Alle RAM haben aber folgendes gemeinsam: Die geforderte hohe Speicherdichte verlangt eine spezielle platzsparende Schaltungstechnik, welche nicht nur digitale Elemente, sondern auch analoge Schaltungsteile einsetzt.

Dieser Aufsatz beschränkt sich im folgenden auf die Betrachtung solcher analoger Schaltungsteile in einem statischen 4096-bit-RAM in CMOS-Technologie, welches vom Verfasser entwickelt worden ist.

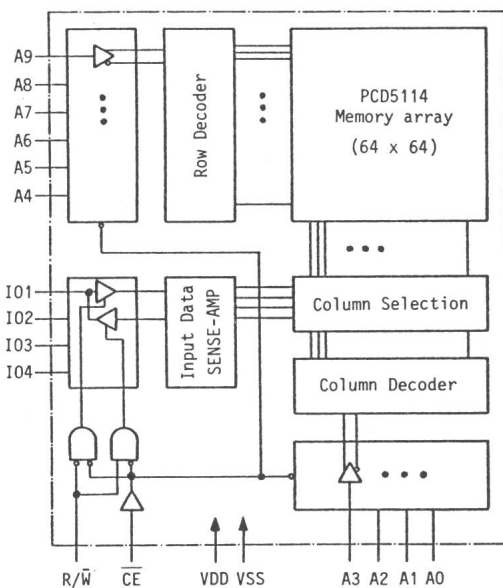


Fig. 1 Blockdiagramm

A9, ...A0	Adresseingänge
R/ \bar{W}	Read/Write Eingang
\bar{CE}	Chip enable Eingang
IO1, ...IO4	Daten-Ein-/Ausgänge
V _{DD}	Speisung + 5 V
V _{SS}	Speisung 0 V (ground)

2. Aufbau und Funktion eines statischen RAM

2.1 Blockdiagramm

Ein statisches 4-k-RAM mit der Organisation $1\text{ k} \times 4\text{ bit}$ umfasst folgende Funktionsblöcke (Fig. 1):

- Adresseingänge A9, ...A0
- Adressbuffer
- Zeilen-Decoder (Row- oder X-Decoder)
- Speichermatrix (Memory array)
- Spaltenselektion (Column- oder Y-Selektion)
- Spalten-Decoder (Column- oder Y-Decoder)
- Leseverstärker (Sense-Amplifier)
- Daten-Ein-/Ausgänge IO1, ...IO4
- Schreiblogik
- Steuerlogik

Die Speichermatrix setzt sich aus den einzelnen Speicherzellen zusammen. Sie ist in horizontaler Richtung von sog. Wortleitungen durchzogen. Eine vom X-Decoder aktivierte Wortleitung selektiert die entsprechende Zeile (Row) der Speichermatrix. In vertikaler Richtung sind alle Zellen einer Spalte (Column) mit sog. Bitleitungen verbunden. Pro Spalte werden zwei benötigt. Die Bitleitungen übertragen die gespeicherte Information der ganzen selektierten Matrixzeile von den einzelnen Zellen zur Spaltenselektion, wo ein ausgewähltes Bitleitungspaar zum Leseverstärker durchgeschaltet wird. Die Selektionsschalter sind bidirektionale Schalter, welche vom Y-Decoder angesteuert werden.

Der Leseverstärker regeneriert das schwache, symmetrische Signal und steuert damit die kräftigen Ausgangsstufen.

Zu speichernde Daten werden via Spaltenselektion in die gewünschte Spalte eingewiesen und in diejenige Zelle abgelegt, welche im Kreuzungspunkt von aktivierter Wortleitung und selektiertem Bitleitungspaar liegt.

Eine Steuerlogik liefert die notwendigen Steuersignale für die einzelnen Funktionsblöcke.

Die Speicherzelle, Spaltenselektion und der Leseverstärker sind von der Arbeitsweise und Schaltungstechnik her gesehen analoge Schaltungsteile. Sie sollen näher betrachtet werden.

2.2 Funktion

Ein statisches 4-k-RAM ($1\text{ k} \times 4\text{ bit}$) kennt im wesentlichen drei Betriebsarten: Lesen, Schreiben und Ruhebetrieb (stand-by).

Lesevorgang:

An die Adresseingänge A9 bis A0 wird eine Binärzahl (Adresse) angelegt. Die höherwertigen Bit A9 bis A4 (X-Adresse) werden im X-Decoder in einen (2^4)-Code umgewandelt und aktivieren so eine der 64 Wortleitungen. Die Bit A3 bis A0 (Y-Adresse) wählen via Y-Decoder und Y-Selektion vier Spalten aus. Die vier selektierten Zellen können jetzt ge-

lesen werden. Der eigentliche Lesezyklus wird aber erst durch die korrekte Ansteuerung der Steuereingänge R/\bar{W} und \bar{CE} gemäss Figur 2 ausgelöst, worauf die Leseverstärker eingeschaltet werden. Nach der Adress-Zugriffszeit (Address Access Time t_{AA}) erscheinen die vier Datenbit am Ausgang.

Schreibvorgang:

In gleicher Weise wie beim Lesen des RAM wird eine Adresse angelegt, worauf die entsprechenden vier Zellen selektiert werden. Durch die Ansteuerung gemäss Figur 3 wird ein Schreibzyklus ausgelöst. Zunächst werden die Ausgangstreiber in den hochohmigen Zustand geschaltet. Anschliessend kann das zu schreibende 4-Bit-Wort an die Daten-Ein-/Ausgänge angelegt werden. Es wird sofort auf die entsprechenden Bitleitungen geschaltet und so in die Zellen eingeschrieben.

Ruhebetrieb:

Beim Ruhebetrieb ($\bar{CE} = H$) werden alle internen Arbeitsströme abgeschaltet. Es fließen nur noch verschwindend kleine Leckströme ($I_{DDs} \approx 10 \text{ nA}$).

Diese Eigenschaft macht CMOS-RAM besonders attraktiv; bei einem Ausfall der Speisespannung kann eine Batterie den Ruhestrom liefern und so den drohenden Datenverlust abwenden.

3. Die Speicherzelle

3.1 Prinzip

Die Speicherzelle ist das häufigste Element in einem RAM. Sie muss deshalb möglichst klein sein. Das kann nur erreicht werden, wenn die Anzahl der verwendeten MOS-Transistoren auf das absolut Notwendige reduziert wird. In Figur 4 ist das Schaltungsprinzip einer Speicherzelle dargestellt. Im wesentlichen werden zwei Inverter benötigt, welche so geschaltet sind, dass zwei stabile Arbeitspunkte existieren. Dies entspricht den beiden logischen Zuständen eines Bit. Mit zwei Selektions-

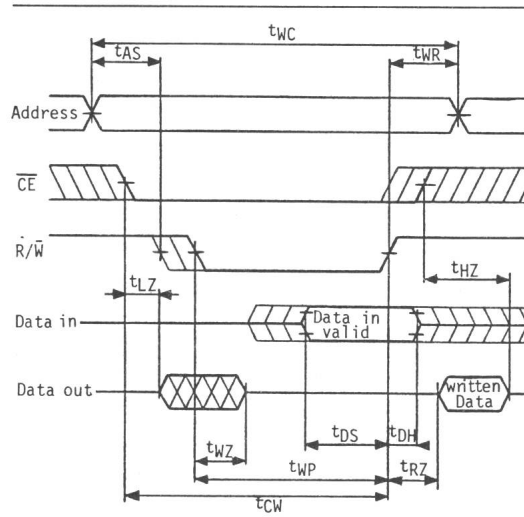


Fig. 3 Schreibzyklus

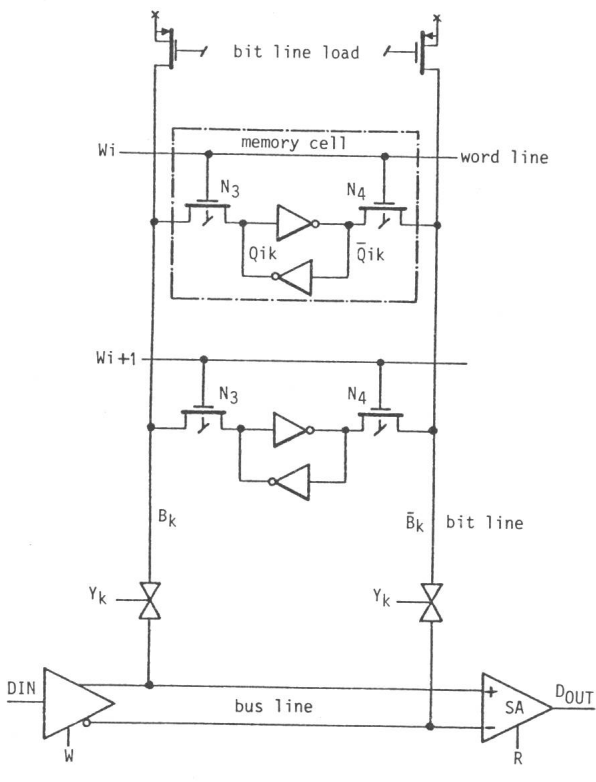


Fig. 4 Prinzip Y-Selection

B_k Bitleitung (Spalte k)
 \bar{B}_k Inverse Bitleitung

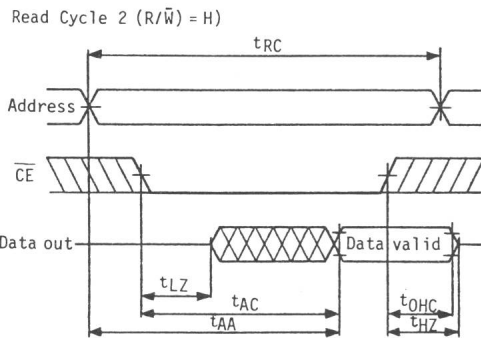
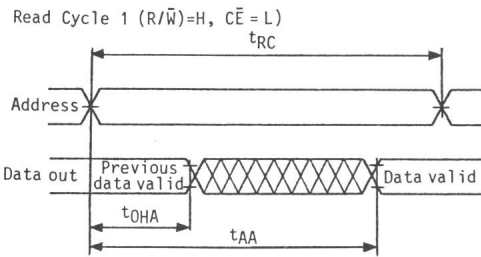


Fig. 2 Lesezyklus

- R/\bar{W} Read/Write Eingang
- \bar{CE} Chip enable Eingang
- L Logische 0 (low)
- H Logische 1 (high)

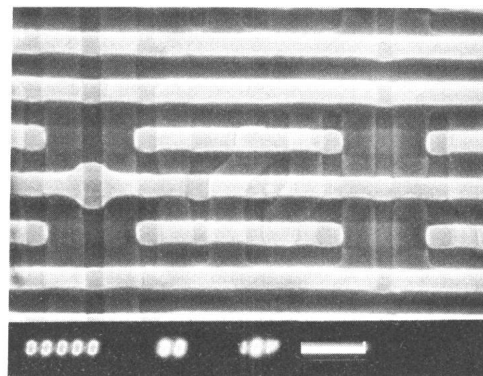


Fig. 5 Elektronenmikroskop-Aufnahme der RAM-Zelle

Transistoren (N3, N4) kann das Inverterpaar an die vertikalen Bitleitungen angeschaltet werden. Um eine möglichst kleine Zelle zu erhalten, wird der Herstellungsprozess bis an die Grenze des Möglichen getrieben (Fig. 5). Häufig wird ein Prozess auch nur für die Herstellung von RAM entwickelt.

Einige der heute angewendeten Zellentypen sind in Figur 6 dargestellt. Für ein RAM mit sehr niedrigem Ruhestrom kommt nur eine Sechs-Transistor-Zelle in Frage.

Die Überlegungen, welche im nächsten Abschnitt über das Lese/Schreib-Prinzip angestellt werden, gelten für diese Sechs-Transistor-Zelle. Sie können aber ohne weiteres sinngemäss auf die andern Typen übertragen werden.

3.2 Lese/Schreib-Prinzip

Zuerst sollen der Lese- und Schreibvorgang qualitativ beschrieben werden. In Figur 7 sind beide Fälle skizziert. Die Dicke der gezeichneten Transistorsymbole soll ein Mass für den Leitwert G_{ON} im eingeschalteten Zustand sein. Ein schwarz ausgefülltes Symbol bedeutet zudem, dass der betreffende Transistor gerade eingeschaltet ist; weiss bedeutet ausgeschaltet.

Lesevorgang

Am Anfang sei der Knoten Q auf Erdpotential, d.h., die Zelle hat eine logische Null gespeichert. Wird sie nun selektiert, indem die Transistoren N3 und N4 mit der Wortleitung W_i eingeschaltet werden, so fliesst ein Lesestrom I_R vom Lastwiderstand P3 am Ende der Bitleitung B_K durch den Selektionstransistor N3 in die Zelle hinein. Der grösste Spannungsabfall tritt dabei über dem Transistor N3 auf. Nachdem der Lesestrom die Bitleitungskapazität (nicht gezeichnet) umgeladen hat, entsteht am Lastwiderstand ein verwertbarer Spannungsabfall von ca. 300 mV.

Im Interesse eines kleinen Betriebsstromes wählt man einen möglichst kleinen Lesestrom, da alle Zellen der selektierten Zeile diesen Strom statisch konsumieren. Andererseits sollte die Bitleitungskapazität (ca. 1,5 pF) möglichst schnell umgeladen werden, damit der Lesevorgang nicht unnötig lange dauert. Dies erfordert aber einen hohen Lesestrom. Das vorliegende statische Arbeitsprinzip entschärft den Konflikt, indem ein kleiner Lesestrom zusammen mit einem kleinen Spannungshub an der Bitleitung ein genügend rasches Signal liefert. Es kostet gesamthaft weniger Strom, das schwache Signal nach der Spaltenselektion zu verstärken, als alle Leseströme zu erhöhen.

Das einfache statische Arbeitsprinzip benötigt zudem keine Lese-Erholzeit (Read Recovery Time), da die Lesespannung an der Bitleitung nie einen so niedrigen Wert erreicht, dass die nächste gelesene Zelle versehentlich überschrieben wird. Bei vollem Spannungshub müssten die Bitleitungen vor jedem Lesevorgang auf eine ungefährliche Spannung aufgeladen werden (precharge). Einige RAM-Hersteller verwenden das Precharge-Prinzip. Sie nehmen in Kauf, dass ihr RAM nicht voll statisch gelesen werden kann (ohne \overline{CE} -Takt), was bei RAM mit 'Address Latches' sowieso nicht möglich ist, ausser man leite den Precharge-Impuls in einer aufwendigen Schaltung von den Adress-Übergängen ab (Address Activated).

Schreibvorgang

Vor dem Schreiben sei in der betrachteten Zelle eine '1' gespeichert, eine '0' soll eingeschrieben werden. Der Knoten Q

befindet sich also vorerst auf V_{DD} -Potential. Beim Schreibvorgang wird die Bitleitung B_K auf Erdpotential geschaltet. In der Folge fliesst ein Schreibstrom I_W aus der Zelle heraus via Selektions-Transistor N3 in den Bitleitungs-Treiber hinein. Als Ersatz für die ganze Schaltung (Fig. 4) ist in Figur 7 ein einzelner N-Kanal-Transistor ($\overline{W}_D K$) eingezeichnet.

Der grösste Spannungsabfall tritt über dem Transistor P1 auf; mit andern Worten, die Speicherzelle kippt und hat fortan eine logische '0' gespeichert. Eine logische '1' wird geschrieben, indem die zweite Bitleitung \overline{B}_K an Erdpotential geschaltet wird.

Die qualitative Beschreibung des Lese/Schreib-Vorgangs gibt schon einige Hinweise, wie die Zelle zu dimensionieren ist. Ein quantitatives Kriterium, das auch die grossen Streuungen im Prozess berücksichtigt, wird im nächsten Abschnitt besprochen.

3.3 Die I-U-Charakteristik der Zelle

Die Transistoren der RAM-Zelle sind so zu dimensionieren, dass folgende zwei Bedingungen erfüllt sind: Beim Lesen darf die Zelle nicht versehentlich überschrieben werden; beim Schreiben muss die Zelle sicher kippen.

Ein übersichtliches Hilfsmittel zur Beurteilung dieser Bedingungen ist eine I-U-Charakteristik gemäss Figur 8.

In Gedanken wird eine Spannungsquelle U_Q in die Zelle geschaltet. Ihre eingeprägte Spannung wird von 0 bis V_{DD} variiert. Die beiden Ströme I_1 und I_2 sind in Funktion der Spannung U_Q graphisch aufzutragen. Praktisch kann dies der Kleinheit der Zelle wegen nicht durchgeführt werden. Eine experimentelle Bestimmung der Kurven kann man sich auch gar nicht leisten. Die Entwicklungs-, Masken- und Herstellungskosten einer Versuchsserie sind viel zu hoch. Es bleibt nur die Simulation mit einem guten Netzwerk-Analyse-Pro-

Typ	CMOS 6 Transistoren	Enhancement/ Enhancement	Enhancement/ Depletion	Poly load	JFET/ Poly load
Zelle					
Fläche (relativ)	1,5	1,4	1,0	0,5	0,4
I_{DDs}/Stand by Strom	pA	10 μ A	1 μ A	nA	nA
Technologie	CMOS	NMOS/CMOS	NMOS	NMOS/CMOS	CMOS

Fig. 6 RAM-Zellen

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
NMOS n-Channel Metal Oxide Semiconductor
JFET Junction Field Effect Transistor

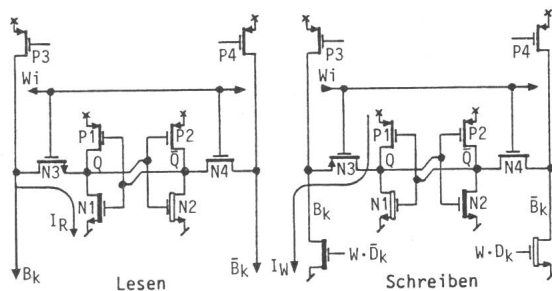


Fig. 7 Lese-/Schreib-Vorgang

I_R Lesestrom
 I_W Schreibstrom

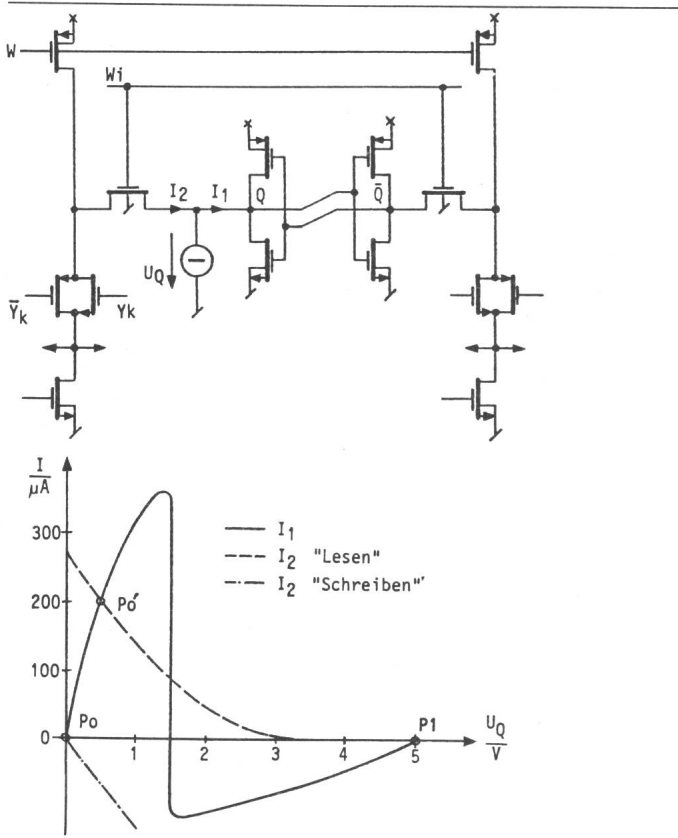


Fig. 8 I-U-Charakteristik

gramm wie SPICE, PHILPAC, DOMOS usw., wo die Berechnung von I-U-Kennlinien sehr leicht möglich ist.

In den Kennlinien treten die obigen Bedingungen anschaulich hervor:

- Beim Lesen schneiden sich die Zellenkennlinie $I_1(U_Q)$ und die Kennlinie $I_2(U_Q)$ der Aussenwelt in zwei Punkten P_0' und P_1 . Der Schnittpunkt P_1 entspricht einer logischen Eins. Der zweite Punkt P_0' entspricht dem Lesen einer logischen Null, wobei der Lesestrom fließt. Die erste Bedingung ist erfüllt, wenn der Schnittpunkt um einen genügend hohen Sicherheitsabstand unter dem Scheitel der Zellenkennlinie liegt und die Spannung einen Schwellwert nicht überschreitet.

- Beim Schreiben wird die Kennlinie $I_2(U_Q)$ nach unten verschoben, so dass nur noch der Schnittpunkt P_0 existiert. P_0 entspricht der geschriebenen Null. Die zweite Bedingung ist erfüllt, wenn der Abstand zwischen der Senke von $I_1(U_Q)$ und der Kurve $I_2(U_Q)$ genügend gross ist.

Im Rahmen dieser Bedingungen kann die Geometrie der Transistoren der Zelle frei variiert werden, um weitere Bedingungen wie die Höhe des Lesestromes sowie die Funktion der Zelle über einen grossen Speisespannungs- und Temperaturbereich zu garantieren, und das bei möglichst kleiner Zellfläche.

4. Der Leseverstärker

4.1 Prinzip

Der Leseverstärker soll bei hoher Gleichtaktspannung und kleinem differentiellen Eingangssignal ein Ausgangssignal mit dem vollen CMOS-Pegel liefern. Eine Schaltung, welche den geforderten Bedingungen entspricht, ist in Fig. 9 dargestellt.

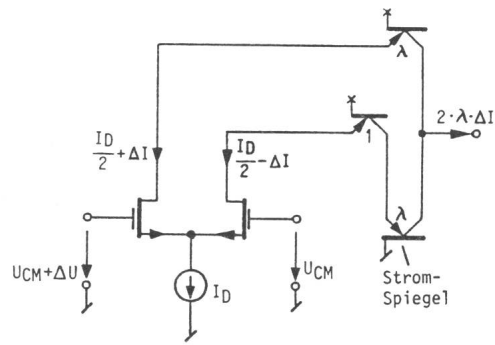


Fig. 9 Leseverstärker-Prinzip

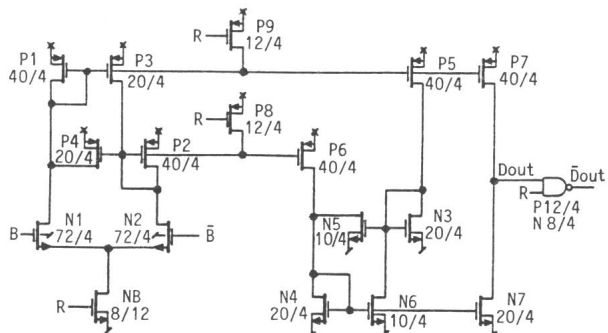


Fig. 10 Leseverstärker

Der Leseverstärker besteht aus einer differentiellen Eingangsstufe und einigen Stromspiegeln, welche dafür sorgen, dass am Ausgang der volle Hub erreicht werden kann. Er reagiert sehr unempfindlich auf Streuungen der Prozessparameter.

Die üblichen Stromspiegel haben den Nachteil, dass sie zwar schnell auf eine Stromzunahme ansprechen, aber leider nicht auf eine Stromabnahme. Durch kreuzgekoppelte Stromspiegel kann dieser Nachteil behoben werden.

4.2 Die optimierte Schaltung

Die mittels SPICE-Simulation optimierte Schaltung ist in Figur 10 dargestellt. Eine erstaunlich kurze Reaktionszeit von max. 14 ns bei einem 100-mV-Eingangssignal wird von SPICE

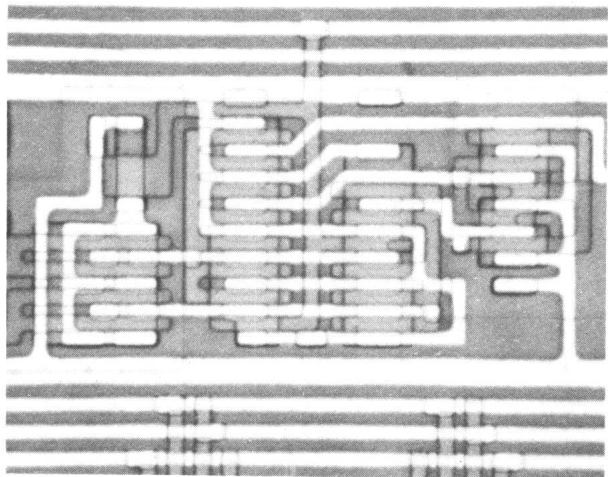


Fig. 11 Leseverstärker (Vergrößerung 500:1)

errechnet. Leider kann dieses Ergebnis nicht direkt messtechnisch verifiziert werden, jede Sonde würde den Verstärker kapazitiv überlasten.

Eine indirekte Bestätigung ist aber möglich: Die gemessene Address Access Time des RAM (typisch 90 ns) stimmt recht gut mit dem berechneten Wert überein, so dass der Simulation einigermaßen vertraut werden darf.

In Figur 11 ist der realisierte Leseverstärker in 500facher Vergrößerung abgebildet. Die Aluminiumverbindungen haben

eine minimale Breite von 4 μm , der Rasterabstand beträgt 8 μm . Für die Herstellung des 4-k-RAM wird der CMOS-Prozess mit 4- μm -Geometrie und selbstjustierenden Kontakten verwendet, welcher von J. Solo bei Faselec AG, Zürich, entwickelt worden ist.

Adresse des Autors

E. Feller, Faselec AG, Räfelstrasse 29, 8045 Zürich.

Literatur – Bibliographie

DK: 621.38.049.037.33

SEV-Nr. A 913

Electronique des signaux analogiques. Par J. Auvray. Paris, Dunod, 1980; bro., 8°, X/350 p., fig., tab. Collection Dunod Université

Cet ouvrage traite des principes de base de l'électronique analogique. L'auteur décrit et analyse les circuits électroniques simples dont la compréhension permet d'aborder l'étude des systèmes plus complexes.

La première partie contient des rappels des notions fondamentales de traitement des signaux (séries de Fourier, fonctions de transfert, distorsions), ainsi que la description et les caractéristiques des composants passifs et actifs utilisés actuellement. La deuxième partie est consacrée aux filtres et aux amplificateurs de faible puissance. Elle débute par un résumé des méthodes d'analyse et de synthèse des filtres passifs. Suit un chapitre important consacré aux techniques de l'amplification: amplificateurs opérationnels et ses applications, amplificateurs pour signaux alternatifs (basse fréquence, vidéo fréquence, haute fréquence, selectif, ...), contre-réaction et stabilité, bruit. Une étude des filtres actifs termine cette seconde partie. Dans la troisième partie sont rassemblées les études de quelques circuits classiques en électronique comme les redresseurs, les stabilisateurs, les amplificateurs de puissance, les amplificateurs non linéaires, les oscillateurs et bascules, les modulateurs et démodulateurs.

Ce livre passe en revue les principales techniques de l'électronique analogique. Pour chacune, l'auteur définit les buts recherchés, décrit les circuits habituellement utilisés et analyse leur comportement souvent de façon détaillée et agrémentée d'exemples numériques. Par sa forme, son niveau technique, par l'étendue de la matière traitée et malgré une présentation moyenne (surtout pour les figures), cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants des écoles techniques et universitaires.

A. Decurnex

DK: 621.313 : 621.314

SEV-Nr. A 912

An introduction to electrical machines and transformers. By George McPherson. New York a.o. John Wiley and Sons, 1981; 8°, XVIII/557 p., fig. Price: cloth £ 14.30

Das vorliegende Lehrbuch vermittelt die wesentlichen Grundlagen über die Theorie, die Wirkungsweise sowie das Betriebsverhalten elektrischer Maschinen und Transformatoren.

Nach einem allgemeinen Teil werden die Synchronmaschine, der Transformator, die Asynchronmaschine, die Gleichstrommaschine und die Einphasenmaschine behandelt. In drei Anhängen wird eine Übersicht über die Berechnung des magnetischen Kreises elektrischer Maschinen gegeben, über die Zusammenhänge zwischen den elektrischen Grössen in symmetrischen, dreiphasigen Netzen sowie über die Beschreibung der Schenkelpolmaschine in der Zweiachsentheorie.

Zu jeder der beschriebenen Maschinenarten folgt nach einer kurzen Einführung über ihren Aufbau die Ableitung und Anwendung des Ersatzschaltbildes, die Beschreibung der experimentellen Bestimmung der Maschinenkenngrössen sowie des Regulierverhaltens. Auf Sonderbauarten wie Autotransformator, PAM (pole-amplitude-modulation)-Motoren, Permanenterregung bei Gleichstrommaschinen usw. wird ebenfalls eingegangen. Die Synchronmaschine ausgenommen, werden Übergangsvorgänge nicht behandelt.

Das Buch ist gut gegliedert und mit modernem Bildmaterial und anschaulichen Skizzen versehen. An mathematischen Hilfsmitteln sind Kenntnisse in einfacher Differential- und Integralrechnung sowie in der Zeigerdarstellung erforderlich. Das Buch wendet sich an Studenten der Ingenieurwissenschaften, der Elektrotechnik und des Maschinenbaus. Es ist aber auch für den in der Praxis stehenden Ingenieur, z.B. in der Projektierung, wertvoll.

A. Meyer